

DLEC系列

适用领域: HDI量产、PCB量产、FPC量产、软硬结合板

产品特点

自动化、智能化: 产速快、稳定性高、对位精度高。

- 高产能: 阻焊: 4-5片/分钟 线路: 5-7片/分钟;
- 高解析度: 最小线宽线距35um/35um;
- 高对位精度: 动态CCD精准对位、 $3\sigma < 8\mu\text{m}$;
- 高效自动曝光流程: 上下菲林自动化粘尘;
- 智能化操作平台: 机器人操作实现多方位上下料工作;
- 专利设计: 双工作台面交替配合, 双面分别对位、同时曝光;
- 体积小: 节省空间, 轻巧配置。

重磅
首推



DLEC系列产品参数

型号		DLEC-350	DLEC-375	DLEC-675
生产规格	平板工件尺寸	150*250 ~ 250*450mm	350*355~620*730mm	305*355~620*730mm
	平板工件厚度	0.01~3.2mm	0.5~5mm	0.5~3.2mm
	底片尺寸	300*500mm (12"*20")	660*760mm(26"*30")	660*760mm(26"*30")
生产能力		内层线路6-7片/分钟	外层线路5~6片/分钟	阻焊4~5片/分钟
光源系统	光源类型	反射式UV-LED	扫描式UV-LED	位移式UV-LED
	能量均匀度	>90%	>90%	>85%
	板面照度	100mw/cm ²	200mw/cm ²	400mw/cm ²
	平行半角	<2°	<3°	<5°
	线路解析度	35μm/35μm	50μm/50μm	65μm/65μm
控制系统		PC+PLC+网络远程控制		
传送系统	输送高度	950±50mm		
	移栽、定位	机械手视觉+伺服传送		
对位系统	对位精度	3σ<8μm	3σ<10μm	3σ<15μm
	对位方式	4CCD对位	8CCD双面分别对位	8CCD双面分别对位
工作台面	接触式曝光	玻璃对玻璃，双面同时曝光		
	清洁方式	上、下菲林自动化粘尘		
冷却方式	曝光室	强制气冷		
	灯源	循环水冷		
机器外型	机械尺寸	3500*1600*2100		
	机械重量	2100kg	2300kg	2500kg
环境要求	空气洁净处理	Class10000		
	温度	20°C±3°C		
	湿度	55%±10%		
外部设施	电力供给	AC 380V 30A	AC 380V 50A	AC 380V 100A
	气压源	0.6Mpa,0.1-5m ³ /min		
	冷冻水供应	20L/min 7-12°C	50L/min 7-12°C	80L/min 7-12°C